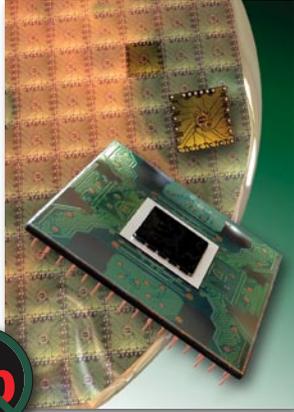


# 半導体組立材料

## ウエハー & チップ・バンブ:

- ウエハーバンブ  
半田ペースト
- ウエハーバンブ  
・フラックス
- フリップチップ  
・フラックス



製品概要:

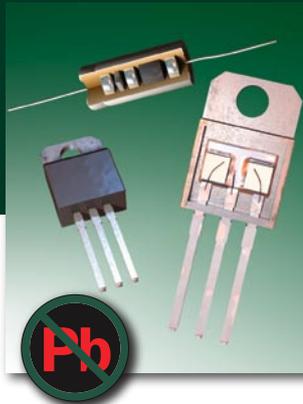
- FC-NC-HT-A1
- Indium 5R
- NF260

## パワー半導体組立材料:

- ダイアタッチ半田ペースト
- ダイアタッチ・ソルダワイヤ
- ダイアタッチ半田プリフォーム

製品概要:

- Indium9.72
- 0.030イ  
ンチ・ワイヤ
- BiAg  
Pbフリー・  
ダイアタッチ  
プリフォーム



## 半導体パッケージ ング組立材料:



- BGA半田  
ボール
- ボールアタ  
ッチ・フ  
ラックス
- サーマル・  
インタフェ  
ース材料

- WS364
- SAC305  
ボール
- 合金プリフ  
ォーム仕様

製品概要:

## 特殊ハンダおよ び特殊アセ ツンブリー:

- シール材
- 共晶AuSnダイ  
アタッチ半田
- MEMS、RF、  
光学用材料



製品概要:

- ワイヤおよびフレーム仕様
- AuSnワイヤ、フレー  
ム、長方形(角型)
- AuSn半田ペースト

裏面に続く→

フォーム番号98107(JA4) R0

半田

INDIUM CORPORATION®

www.indium.com  
 asiapac@indium.com  
 中華人民共和国: +86 (0)512 628 34900  
 シンガポール: +65 6268 8678  
 英国: (0) 1908 580400  
 米国: +1 315 853 4900



ISO 9001  
 認証

# 半導体組立材料

## SMTA認定の技術サービス

- SMTA認定のエンジニアが以下に関するアドバイスを行います:
- 合金の選定と利用
- 半田特性
- フラックスと合金の相性
- 半田形状の選択 (プリフォーム、ワイヤ、リボン、等)
- 受賞に輝く研究開発実績
- テストと評価のためのプロセス・シミュレーション・ラボ
- オンラインデータベース



## Indium Corporation

上から下へ:

**本社:**

クリントン(米国ニューヨーク州)

**特殊メタル部門:**

ユーティカ(米国ニューヨーク州)

**電子化学部門:**

クリントン(米国ニューヨーク州)

**アジア太平洋オペレーション:**

シンガポール

**ヨーロッパ・オペレーション**

ミルトン・キーンズ(英国)

**中国オペレーション:**

蘇州(中華人民共和国)



## Pbフリー実施サポートセンター

- Pbフリーに関する何年もの経験
- プロセス実証済のソリューション
- 国際的に認められた業界エキスパートおよび科学的研究員達が相談を受けます。
- セミナーおよびワークショップ
- Pbフリー態勢査定ソフトウェア
- [www.pb-free.com](http://www.pb-free.com)



ここにある情報は一般的な情報としてのみ提供され、当該製品(販売時に製品パッケージおよびインボイスに記載されている製品保証およびその仕様書に

所属した条件で販売されます)の性能を保証するものではありません。

半田

## INDIUM CORPORATION®

[www.indium.com](http://www.indium.com)  
[asiapac@indium.com](mailto:asiapac@indium.com)  
 中華人民共和国: +86 (0)512 628 34900  
 シンガポール: +65 6268 8678  
 英国: (0) 1908 580400  
 米国: +1 315 853 4900



ISO 9001  
 認証